(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-258617

(43)公開日 平成11年(1999)9月24日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

G02F 1/1343

1/1335

520

G02F 1/1343

1/1335

520

審査請求 有 請求項の数1 OL (全9頁)

(21)出願番号

特願平11-7193

(62)分割の表示

特願平4-230082の分割

(22)出願日

平成4年(1992)8月28日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 神戸 誠

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 三ッ井 精一

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

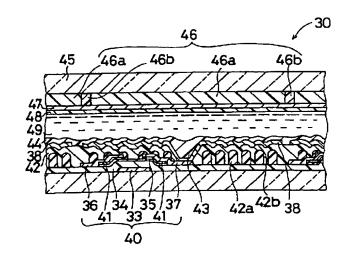
(74)代理人 弁理士 小池 隆彌

(54) 【発明の名称】 反射型液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 表示品位が向上する反射型液晶表示装置の製 造方法を提供すること。

【解決手段】 液晶層を介在して対向配置される一対の 基板のうち、一方基板上の液晶層側表面には、他方基板 側からの入射光を反射する表示絵素である複数の反射電 極と、各反射電極に接続部を介して表示のための電圧を 印加する引回し電極とを形成し、他方基板上の液晶層側 表面には、ほぼ全面にわたって透光性を有する共通電極 を形成して構成される反射型液晶表示装置の製造方法に おいて、前記一方基板の前記引回し電極と前記反射電極 との接続部を除く領域に、凸部に対応したパターンが該 接続部に形成されないように配列された遮光手段を介し て露光することで、樹脂からなる複数の凸部を配列して 形成する工程と、前記凸部を熱処理することで該凸部の 角を取って滑らかにする工程と、前記反射電極を、前記 絶縁膜上に、前記接続領域と重なりを持って、かつ隣り 合う反射電極が相互に間隔を介するように、予め定めら れた領域に形成する工程と、を含むことを特徴とする。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】液晶層を介在して対向配置される一対の基板のうち、一方基板上の液晶層側表面には、他方基板側からの入射光を反射する表示絵素である複数の反射電極と、各反射電極に接続部を介して表示のための電圧を印加する引回し電極とを形成し、他方基板上の液晶層側表面には、ほぼ全面にわたって透光性を有する共通電極を形成して構成される反射型液晶表示装置の製造方法において、

前記一方基板の前記引回し電極と前記反射電極との接続 部を除く領域に、凸部に対応したパターンが該接続部に 形成されないように配列された遮光手段を介して露光す ることで、樹脂からなる複数の凸部を配列して形成する 工程と、

前記凸部を熱処理することで該凸部の角を取って滑らか にする工程と、

前記反射電極を、前記樹脂からなる複数の凸部上に、前 記接続領域と重なりを持って、かつ隣り合う反射電極が 相互に間隔を介するように、予め定められた領域に形成 する工程と、を含むことを特徴とした反射型液晶表示装 20 る。ゲートバス配線3は、走査線として機能している。 置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、入射光を反射する ことによって表示を行う反射型液晶表示装置の製造方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ワードプロセッサ、ラップトップパソコン、ポケットテレビなどへの液晶表示装置の応用が急速に進展している。特に、液晶表示装置の中でも外部から入射した光を反射させて表示を行う反射型液晶表示装置は、バックライトが不要であるため消費電力が低く、薄形であり、軽量化が可能であるため注目されている。

【0003】従来から、反射型液晶表示装置にはTN (ツイステッドネマティック) 方式、ならびにSTN (スーパーツイステッドネマティック) 方式が用いられているけれども、これらの方式では偏光板によって必然的に自然光の光強度の1/2が表示に利用されないことになり、表示が暗くなるという問題がある。

【0004】このような問題に対して、偏光板を用いず、自然光の全ての光線を有効に利用しようとする表示モードが提案されている。このようなモードの例として、相転移型ゲスト・ホスト方式が挙げられる(D. L. White and G. N. Taylor: J. Appl. Phys. 45 4718 1974)。このモードでは、電界によるコレステリック・ネマティック相転移現象が利用されている。この方式に、さらにマイクロカラーフィルタを組合せた反射型マルチカラーディスプレイも提案されている(Tohru Koizu 50

mi and Tatsuo Uchida Proceedings of the SID, Vol. 29
/2, 157, 1988).

【0005】このような偏光板を必要としないモードで さらに明るい表示を得るためには、あらゆる角度からの 入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱する光の強 度を増加させる必要がある。そのためには、最適な反射 特性を有する反射板を作成することが必要となる。上述 の文献には、ガラスなどから成る基板の表面を研磨剤で 粗面化し、フッ化水素酸でエッチングする時間を変える ことによって表面の凹凸を制御し、その凹凸上に銀の薄 膜を形成した反射板について記載されている。図10は アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素 子である薄膜トランジスタ(以下、TFTと記す) 1を 有する基板2の平面図であり、図11は図10に示す切 断面線XI-XIから見た断面図である。ガラスなどの 絶縁性の基板2上に、クロム、タンタルなどから成る複 数のゲートバス配線3が互いに平行に設けられ、ゲート バス配線3からはゲート電極4が分岐して設けられてい

【0006】ゲート電極4を覆って基板2上の全面に窒化シリコン(SiNx)、酸化シリコン(SiOx)などから成るゲート絶縁膜5が形成されている。ゲート電極4の上方のゲート絶縁膜5上には、非晶質シリコン(以下、a-Siと記す)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層6が形成されている。半導体層6の一方の端部には、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極7が重畳形成されている。また、半導体層6の他方の端部には、ソース電極7と同様にチタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極8が重畳形成されている。ドレイン電極8の半導体層6と反対側の端部には、ITO(Indium TinOxide)から成る絵素電極9が重畳されている。

【0007】図10に示すように、ソース電極7にはゲートバス配線3に前述のゲート絶縁膜5を挟んで交差するソースバス配線10が接続されている。ソースバス配線10は、信号線として機能している。ソースバス配線10も、ソース電極7と同様な金属で形成されている。ゲート電極4、ゲート絶縁膜5、半導体層6、ソース電40 極7およびドレイン電極8はTFT1を構成し、該TFT1は、スイッチング素子の機能を有している。

【0008】図10および図11に示すTFT1を有する基板2を反射型液晶表示装置に適応しようとすれば、 絵素電極9をアルミニウム、銀などの光反射性を有する 金属で形成するばかりでなく、ゲート絶縁膜5あるいは その上に凹凸を形成する必要がある。一般に、無機物か ら成る絶縁膜にテニパの付いた凹凸を均一に形成することは困難である。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】図10および図11に

1

示されるように、反射電極9とソースバス配線10とをゲート絶縁膜5上に形成する際には、反射電極9とソースバス配線10とが導通しないように間隙9aが形成される。また、TFT1上に反射電極9を形成した場合、ソース電極7とドレイン電極8とが導通し、TFT1がスイッチング素子として機能しなくなるため、TFT1上に反射電極9を形成することができない。

【0010】表示の輝度を向上するためには、反射電極9は大きいほど好ましい。けれども、上述のように反射電極9はソースバス配線10と接触せず、またTFT1のドレイン電極8以外とは重ならないように形成しなければならず、反射電極9の面積が小さく、したがって輝度が低く、反射型液晶表示装置の表示品位が低いという問題がある。

【0011】本発明の目的は、上述の問題を解決し、表示品位が向上する反射型液晶表示装置の製造方法を提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、液晶層を介在 して対向配置される一対の基板のうち、一方基板上の液 晶層側表面には、他方基板側からの入射光を反射する表 示絵素である複数の反射電極と、各反射電極に接続部を 介して表示のための電圧を印加する引回し電極とを形成 し、他方基板上の液晶層側表面には、ほぼ全面にわたっ て透光性を有する共通電極を形成して構成される反射型 液晶表示装置の製造方法において、前記一方基板の前記 引回し電極と前記反射電極との接続部を除く領域に、凸 部に対応したパターンが該接続部に形成されないように 配列された遮光手段を介して露光することで、樹脂から なる複数の凸部を配列して形成する工程と、前記凸部を 熱処理することで該凸部の角を取って滑らかにする工程 と、前記反射電極を、前記樹脂からなる複数の凸部上 に、前記接続領域と重なりを持って、かつ隣り合う反射 電極が相互に間隔を介するように、予め定められた領域 に形成する工程と、を含むことを特徴とした反射型液晶 表示装置の製造方法である。

【0013】以下に、本発明の作用について説明する。 【0014】本発明に従えば、反射型液晶表示装置は、 対向する一対の透明基板間に液晶層を介在して形成され る。このとき、一方の基板の液晶層側表面には複数の反 射電極と引回し電極とが形成され、他方の基板の液晶層 側表面には共通電極が形成される。前記反射電極は表示 絵素であり、前述の他方基板および共通電極を介して入 射する入射光を反射することによって表示が行われる。 ゲートバス配線、ソースバス配線および薄膜トランジス タなどで実現される前記引回し電極は、各反射電極に表 示のための電圧を印加する。他方基板上に形成されて いる。

【0015】本発明においては、前記反射電極は、前記

4

一方基板上に不規則に配列された絶縁膜である樹脂からなる複数の凸部を覆って予め定められた領域に形成される。この際、隣り合う反射電極は、相互に間隙を介して形成されている。前記絶縁膜は前記凸部を覆って形成されるため、前記絶縁膜は前記凸部に応じた凹凸を有する。前述のように、前記反射電極は前記凹凸を有する絶縁膜上に形成されるため、反射電極表面にもまた前記凹凸に対応する凹凸が形成される。光反射面に凹凸を形成することによって、あらゆる角度からの入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱する光の強度が増加して表示輝度が向上し、表示のコントラストが向上する。

【0016】また前記反射電極と引回し電極とは、接続部を除き、絶縁膜を介して形成される。このため、反射電極を形成する領域は、引回し電極に影響されることはなく、隣り合う反射電極が電気絶縁状態を保つ範囲内で面積を増加することが可能であり、表示の輝度が向上する。また、前記反射電極と引回し電極との接続部を除いて凸部を形成しているため、引回し電極から各反射電極に表示のための電圧を良好に印加することが可能になる。

[0017]

【発明の実施の形態】図1は本発明の一実施形態である 反射型液晶表示装置30の断面図であり、図2は図1に 示される基板31の平面図である。ガラスなどから成る 絶縁性の基板31上に、クロム、タンタルなどから成る 複数のゲートバス配線32が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線32からはゲート電極33が分岐してい る。ゲートバス配線32は、走査線として機能してい る。

30 【0018】ゲート電極33を覆って基板31上の全面に、窒化シリコン(SiNx)、酸化シリコン(SiOx)などから成るゲート絶縁膜34が形成されている。ゲート電極33の上方のゲート絶縁膜34上には、非晶質シリコン(以下、a-Siと記す)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層35が形成されている。半導体層35の両端部には、a-Siなどから成るコンタクト電極41が形成されている。一方のコンタクト電極41上には、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極36が重畳形成され、他方のコンタクト電極41上には、ソース電極36と同様に、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極37が重畳形成されている。

【0019】図2に示すようにソース電極36には、ゲートバス配線32に前述のゲート絶縁膜34を挟んで交差するソースバス配線39が接続されている。ソースバス配線39は、信号線として機能している。ソースバス配線39も、ソース電極36と同様の金属で形成されている。ゲート電極33、ゲート絶縁膜34、半導体層35、ソース電極36およびドレイン電極37は薄膜トランジスタ(以下、TFTと記す)40を構成し、該TF

T40は、スイッチング素子の機能を有する。

【0020】TFT40が形成された基板31上には、複数の凸部42aが後述するコンタクトホール43が形成される領域を除いて、不規則に形成されている。凸部42aを覆って、基板31上全面に有機絶縁膜42が形成されている。有機絶縁膜42には、凸部42aに応じた凸部42bが生じる。ドレイン電極37部分には、コンタクトホール43が形成されている。有機絶縁膜42上にアルミニウム、銀などから成る反射電極38が形成され、反射電極38はコンタクトホール43においてドレイン電極37と接続される。さらにその上には、配向膜44が形成される。

【0021】反射電極38は、図2に示されるようにゲートバス配線32の一部およびソースバス配線39の一部に有機絶縁膜42を介して重畳されるように形成されている。このため反射電極38は、隣り合う反射電極38が電気的に絶縁状態を保つ範囲で面積を大きくすることができる。このため、表示画面の開口率が大きくなり、明るい表示が可能となる。本実施形態に従えば、開口率を90%以上にすることができる。

【0022】基板45上には、カラーフィルタ46が形成される。カラーフィルタ46の基板31の反射電極38に対向する位置には、マゼンタまたはグリーンのフィルタ46aが形成され、反射電極38に対向しない位置にはブラックのフィルタ46bが形成される。カラーフィルタ46上の全面には、ITO(Indium Tin Oxide)などから成る透明な電極47、さらにその上には配向膜48が形成される。

【0023】両基板31、45は、反射電極38とフィルタ46aとが一致するように対向して貼り合わせられ、間に液晶49が注入されて反射液晶表示装置30が完成する。

【0024】図3は図1および図2に示される凸部42 aを有する反射電極38を基板31上に形成する形成方法を説明する工程図であり、図4は図3に示す形成方法を説明する断面図であり、図5は図3の工程a5で用いられるマスク51の平面図である。図4(1)は図3の工程a4を示し、図4(2)は図3の工程a5を示し、図4(3)は図3の工程a6を示し、図4(4)は図3の工程a8を示し、図4(5)は図3の工程a8を示し、図4(5)は図3の工程a9を示している。

【0025】工程a1ではガラスなどから成る絶縁性の基板31上にスパッタリング法によって3000Åの厚さのタンタル金属層を形成し、この金属層をホトリソグラフ法およびエッチングによってパターニングを行い、ゲートバス配線32およびゲート電極33を形成する。工程a2では、プラズマCVD法によって4000Åの厚さの窒化シリコン(SiNχ)から成るゲート絶縁膜34を形成する。

【0026】工程a3では半導体屬35となる厚さ10

00Åのa-Si層と、コンタクト層41となる厚さ400Åのn⁺型a-Si層とをこの順で連続的に形成する。形成されたn⁺型a-Si層およびa-Si層のパターニングを行い、半導体層35およびコンタクト層41を形成する。工程a4では、基板31の全面に厚さ2000Åのモリブデン金属をスパッタ法によって形成し、このモリブデン金属層のパターニングを行って、ソース電極36、ドレイン電極37およびソースバス配線39を形成し、TFT40が完成する。図4(1)は、

工程 a 4 までの処理終了後のTFT40が形成された基板31の断面図である。

【0027】工程a5では、TFT40を形成した基板 31上全面に光感性樹脂であるホトレジスト(OFPR-800)を1200Åの厚さに塗布し、図5に示されるマスク51を用いて、図4(2)に示されるように凸部 42aを形成する。マスク51には、斜線で示す円形の遮光領域51a、51bが不規則に形成されている。 遮光領域51aの直径の長さD1は、遮光領域51bの直径の長さD2よりも大きく形成されている。たとえば 20 $D1は<math>10\mu$ mであり、D2は 5μ mである。

【0028】本実施形態では、2種の遮光領域51a、51bを有するマスク51を用いたけれども、マスク51はこれに限定されない。遮光領域は1種類の円形でもよく、また3種類以上の円形でもよい。マスク51の、後述する工程a7でコンタクトホール43を形成する領域に、遮光領域51a、51bを形成しないようにすれば、コンタクトホール43領域に凸部42aを形成することが防止される。

【0029】工程 a 6 では、基板 3 1 上全面にポリイミ)ド樹脂を 1 μ mの厚さに塗布し、図 4 (3) に示される ように有機絶縁膜 4 2 を形成する。工程 a 7 では、ホト リソグラフ法およびドライエッチング法を用いて有機絶 縁膜 4 2 にコンタクトホール 4 3 を形成する。

【0030】工程a8では、凸部42bを有する有機絶縁膜42上全面に図4(4)に示されるようにアルミニウムから成る金属薄膜を形成し、工程a9では図4

(5) に示されるように凸部42b上に反射電極38をパターニングする。反射電極38は、有機絶縁膜42に形成されたコンタクトホール43を介してTFT40のドレイン電極37と接続されている。反射電極38のパターニング時に、有機絶縁膜42の下のホトレジストから成る凸部42aは、露光、現像、アルミニウムのエッチング、レジストの剥離の工程を通しても、何の変化も見られないことを確認している。

【0031】凸部42aの形状は、マスク51の形状、凸部42aとなるホトレジストの厚さによって制御することができることが確認されている。また、凸部42aの角は、凸部42aの形成後、熱処理をすることによって容易に取ることができる。

【0032】図1に示される他方の基板45に形成され

6

7

る電極 47 は、たとえば ITOから成り、厚さは 100 O A である。電極 38 、 47 上の配向膜 44 、 48 は、ポリイミドなどを塗布後、焼成することによって形成されている。 基板 31 、 45 間には、たとえば 7μ mあるいは 12μ mのスペーサを混入した図示しない接着性シール剤をスクリーン印刷することによって液晶 49 を封入する空間が形成され、前記空間を真空脱気することによって液晶 49 が注入される。液晶 49 としては、たとえば黒色色素を混入したゲストホスト液晶(メルク社製、商品名 2L12327)に光学活性物質(メルク社製、商品名 811)を 4.5%混入したものを用いる。

【0033】図6は本発明の反射型液晶表示装置30の 反射特性の測定に用いられる反射板70の製造工程を説 明する図であり、図7は図6の工程を説明する断面図で ある。工程 b 1 では、図 7 (1) に示すように厚さ 1. 1 mmのガラス (商品名 7059 コーニング社製) 71の一方表面に、光感性樹脂であるレジスト材料とし て、たとえばOFPR-800(東京応化社製)を好ま しくは500rpm~3000rpmでスピンコートに · よって塗布する。本実施形態では、3000rpmで3 0秒間塗布し、レジスト72を1.2μm成膜した。エ 程b2では、レジスト72を100℃で30分間プリベ ークし、工程 b 3 では、図 7 (2) に示すように、レジ スト72上に円形の遮光領域51a、51bを有するホ トマスク51を配置して露光を行い、工程64では、図 7 (3) に示すようにレジスト72を現像し、基板71 表面に不規則な円形の凸部74を形成した。現像液とし て、2.38%のNMD-3 (東京応化社製)を用い

【0034】工程b5では、ガラス基板71上の凸部7 4を好ましくは120℃~250℃で熱処理すると、図 7(4)に示されるように角がとれて滑らかな凸部74 が形成される。本実施形態では、180℃で30分間熱 処理を行った。工程 b 6 では、図 7 (5) に示すように 凸部74を形成した基板71上に有機絶縁膜74aを形 成した。有機絶縁膜74aとしては、ポリイミド樹脂を 好ましくは920rpm~3500rpmで20秒間ス ピンコートによって塗布する。本実施形態では、220 Orpmで20秒間塗布し、1μmの厚さの有機絶縁膜 74aを成膜した。有機絶縁膜74aには、凸部74に 応じた凸部が生じるが、凸部74よりは滑らかである。 工程 b 7 では、図 7 (6) に示すように有機絶縁膜 7 4 aに金属薄膜75を形成した。金属薄膜75の厚さは、 0. 01μm~1. 0μm程度が適している。本実施形 態では、アルミニウムを真空蒸着することによって金属 薄膜75を形成した。金属薄膜75としては、アルミニ ウム、ニッケル、クロム、銀、銅をあげることができ る。金属薄膜75は、凸部74に沿って形成された有機 絶縁膜74a上に形成されているため、凸部74に応じ た不規則な円形の凸部 7 5 a を有している。以上によって反射板 7 0 を得た。

8

【0035】図8は、反射板70の反射特性の測定法を 説明する側面図である。通常、液晶表示装置30に用い られる基板31、45および液晶49層の屈折率は、各 々約1.5である。反射板70の表面と液晶49層とが 接する構成を想定し、本実施形態では屈折率1.5の紫 外線硬化樹脂77を用いてガラス基板76を反射板70 に密着させて、反射板70の反射特性を測定した。この 10 測定結果は、反射板75の表面と液晶49層の境界にお ける反射特性と同様の結果を与えることを確認してい る。

【0036】図8に示すように、反射特性の測定は、反射板70に入射する入射光79の散乱光80をホトマルチメータ78で検出することによって行われる。反射板70には、その法線に対し角度 θ をもって入射光79が入射する。ホトマルチメータ78は、金属薄膜75上の入射光79が照射される点を通る反射板70の法線方向に固定されている。入射光79の入射角度 θ を変えてホトマルチメータ78で金属薄膜75による散乱光80の強度を測定することによって、反射特性が得られた。

【0037】図9は、入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。入射角度 θ である入射光79の反射強度は、 $\theta=0^\circ$ の線に対する角度 θ の方向に、原点0からの距離として表されている。 $\theta=70^\circ$ の反射強度をP1、 $\theta=60^\circ$ の反射強度をP2、 $\theta=40^\circ$ の反射強度をP3、 $\theta=30^\circ$ の反射強度をP4、 $\theta=-30^\circ$ の反射強度をP5、 $\theta=-40^\circ$ の反射強度をP6、 $\theta=-60^\circ$ の反射強度をP7、 $\theta=-70^\circ$ の反射強度をP8で示している。

【0038】図9では、酸化マグネシウムの標準白色板の反射特性曲線を破線81で示している。 θ = 30°の反射強度P4は、 θ = 30°の酸化マグネシウムの反射強度P10よりも優れており、 θ = -30°の反射強度もまた θ = -30°の酸化マグネシウムの反射強度P11よりも優れていることが判る。

【0039】以上のように本実施形態によれば、形状の制御が容易であり、再現性を有するホトレジストから成る凸部42a上に凸部42aに沿って形成された凸部4 402bを有する有機絶縁膜42上に、凸部42bに沿った反射電極38を形成する。凸部42aの形状を制御することによって良好な反射特性を有する反射電極38が得られ、反射型液晶表示装置の表示品位が向上する。

【0040】また、凸部42aを形成するホトレジストなどの光感光性樹脂の種類や膜厚、熱処理温度を適当に選択すると凸部42aの傾斜角度を自由に制御することができ、これにより反射強度の入射角θ依存性を制御できることを確認している。その上に塗布する有機絶縁膜42の種類や膜厚を変えることによっても、反射強度を50制御できることを確認している。マスク51の遮光領域

9 51a、51bの占める割合を変えることにより、正反 射成分の大きさをも制御することができる。

【0041】また、反射電極38と電極47との間に電 圧印加した場合、ある角度($\theta = 3.0^{\circ}$) から入射した 光に対するパネル法線方向の反射率は約20%で、コン トラスト比は5であった。

【0042】本実施形態の反射型液晶表示装置30で は、基板31の反射電極38を形成した面が、液晶層側 に配されているので視差がなくなり、良好な表示品位が 得られる。本実施形態では、基板31の反射薄膜である 反射電極38が液晶49層側、すなわち液晶49層にほ ぼ隣接する位置に配されている構成となるので、凸部4 2 b の高さはセル厚さよりも小さく、凸部4 2 b の傾斜 角度は液晶49の配向を乱さない程度に穏やかにするの が望ましい。

【0043】さらに本実施形態では、有機絶縁膜42の パターニングをドライエッチング法によって行ったが、 有機絶縁膜42がポリイミド樹脂の場合にはアルカリ溶 液によるウエットエッチング法によって行ってもよい。 また、有機絶縁膜42としてポリイミド樹脂を用いた が、アクリル樹脂などの他の有機材料を用いてもよい。 さらに本実施形態では、基板31として、ガラスなどか ら成る透明な材料を用いたが、シリコン基板のような不 透明な材料でも同様な効果が発揮され、この場合には回 路を基板上に集積できる利点がある。

【0044】なお、前記実施形態においては、表示モー ドとして相転移型ゲスト・ホストモードを取り挙げたけ れども、これに限定されることはなく、たとえば2層式 ゲスト・ホストのような他の光吸収モード、高分子分散 型液晶表示装置のような光散乱形表示モード、強誘電性 液晶表示装置で使用される複屈折表示モードなどでも同 様の効果が得られる。また本実施形態では、スイッチン グ素子としてTFT40を用いた場合について説明した が、たとえばMIM (Metal-Insulator -Metal)素子、ダイオード、バリスタなどを用い たアクティブマトリクス基板にも適用することができ る。

[0045]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、感光性樹 脂を露光、現像し、熱処理を行って得られた複数の不規 40 49 液晶 則な凸部上に、前記凸部に沿って形成された絶縁膜上 に、金属薄膜から成る反射板を絶縁膜の凸部に沿って形

成する。反射板の形状は、感光性樹脂の形状によって決 定される。感光性樹脂は、容易に、かつ均一に再現性よ く制御することが可能であるため、良好な反射特性を有 する反射板を容易に形成することができ、反射型液晶表 示装置の表示品位が向上する。

【0046】また、絶縁膜上に反射電極を形成するた め、薄膜トランジスタなどの引回し電極の影響を受け ず、隣り合う反射電極間の絶縁性を保つ範囲で反射電極 を大きく形成でき、開口率を90%以上にすることがで 10 きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態である反射型液晶表示装置 30の断面図である。

【図2】図1に示される基板31の平面図である。

【図3】図1および図2に示される凸部42aを有する 反射電極38を形成する形成方法を説明する工程図であ る。

【図4】図3に示す形成方法を説明する断面図である。

【図5】図3の工程a5で用いるマスク51の平面図で 20 ある。

【図6】本発明の反射型液晶表示装置30の反射特性の 測定に用いられる反射板70の製造工程を説明する工程 図である。

【図7】図6の工程を説明する断面図である。

【図8】反射板70の反射特性の測定法を説明する斜視 図である。

【図9】入射角度θと反射強度との関係を示すグラフで ある。

【図10】アクティブマトリクス方式に用いられるスイ 30 ッチング素子である薄膜トランジスタ1を有する基板2 の平面図である。

【図11】図10に示す切断面線XI-XIから見た断 面図である。

【符号の説明】

30 反射型液晶表示装置

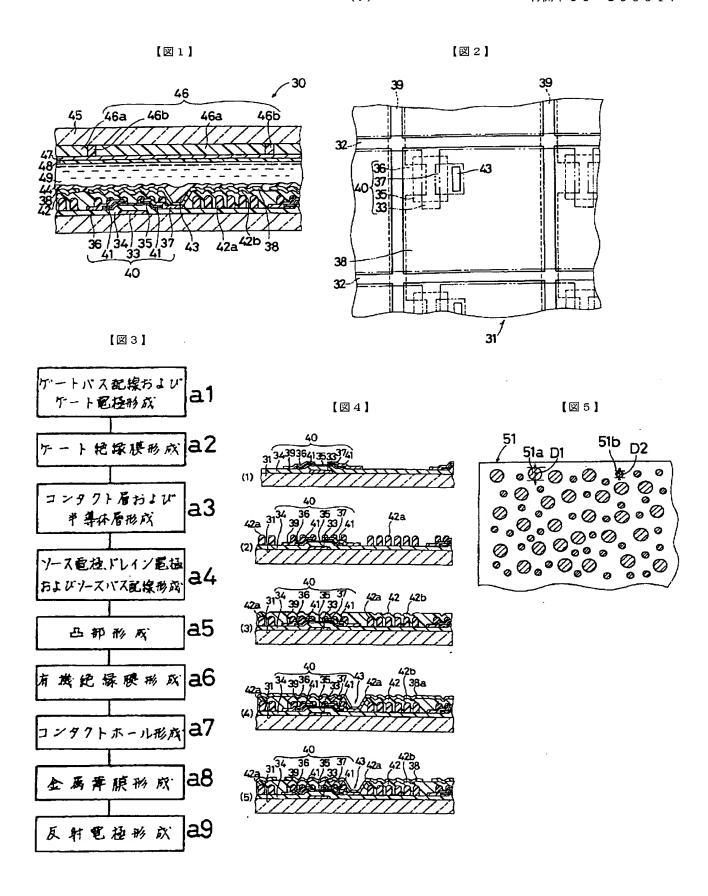
31、45 基板

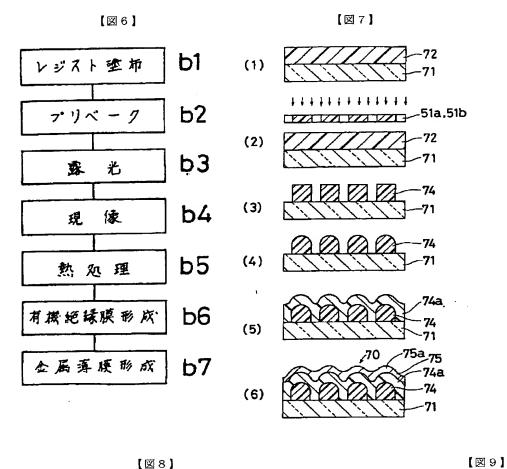
38 反射電極

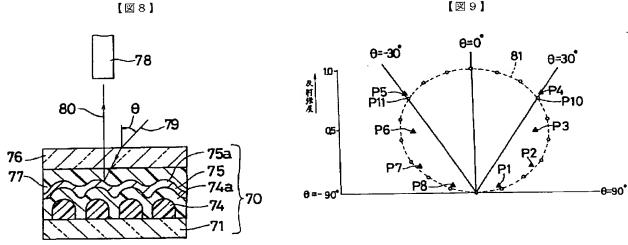
42 有機絶縁膜

42a、42b 凸部

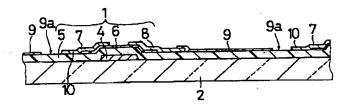
51 ホトマスク



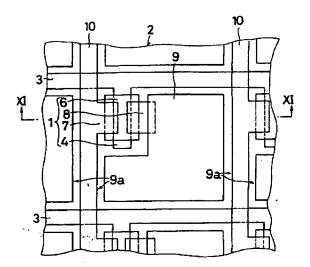




【図11】



【図10】



THIS PAGE BLANK (USPTO)